

(12) 特許協力条約に基づいて公開された国際出願

(19) 世界知的所有権機関
国際事務局

(43) 国際公開日
2024年9月19日(19.09.2024)



(10) 国際公開番号

WO 2024/190881 A1

- (51) 国際特許分類:
C09J 7/35 (2018.01) H01L 21/52 (2006.01)
C09J 11/04 (2006.01) H01L 25/065 (2023.01)
C09J 163/00 (2006.01) H01L 25/07 (2006.01)
C09J 201/00 (2006.01) H01L 25/18 (2023.01)
H01L 21/301 (2006.01)
- (21) 国際出願番号: PCT/JP2024/010073
- (22) 国際出願日: 2024年3月14日(14.03.2024)
- (25) 国際出願の言語: 日本語
- (26) 国際公開の言語: 日本語
- (30) 優先権データ:
PCT/JP2023/010166 2023年3月15日(15.03.2023) JP
PCT/JP2023/029152 2023年8月9日(09.08.2023) JP
- (71) 出願人: 株式会社 レゾナック (RESONAC CORPORATION) [JP/JP]; 〒1057325 東京都港区東新橋一丁目9番1号 Tokyo (JP).
- (72) 発明者: 黒田 孝博 (KURODA Takahiro); 〒1057325 東京都港区東新橋一丁目9番1号 株式会社 レゾナック内 Tokyo (JP).
丹羽 孝明 (NIWA Takaaki); 〒1057325 東京都港区東新橋一丁目9番1号 株式会社 レゾナック内 Tokyo (JP).
- (74) 代理人: 長谷川 芳樹, 外 (HASEGAWA Yoshiki et al.); 〒1000005 東京都千代田区丸の内二丁目1番1号丸の内 M Y P L A Z A (明治安田生命ビル) 9階 創英国際特許法律事務所 Tokyo (JP).
- (81) 指定国(表示のない限り、全ての種類の国内保護が可能): AE, AG, AL, AM, AO, AT, AU, AZ, BA, BB, BG, BH, BN, BR, BW, BY, BZ, CA, CH, CL, CN, CO, CR, CU, CV, CZ, DE, DJ, DK, DM, DO, DZ, EC, EE, EG, ES, FI, GB, GD, GE, GH, GM, GT, HN, HR, HU, ID, IL, IN, IQ, IR, IS, IT, JM, JO, JP, KE, KG, KH, KN, KP, KR, KW, KZ, LA, LC, LK, LR, LS, LU, LY, MA, MD, MG, MK, MN, MU, MW, MX, MY,

(54) Title: FILM ADHESIVE, DICING AND DIE-BONDING INTEGRAL FILM, SEMICONDUCTOR DEVICE, AND MANUFACTURING METHOD FOR SAME

(54) 発明の名称: フィルム状接着剤、ダイシング・ダイボンディング一体型フィルム、並びに半導体装置及びその製造方法

(57) Abstract: Disclosed is a film adhesive containing a thermosetting resin component and an elastomer. In a DSC curve of the film adhesive obtained by differential scanning calorimetry under conditions of a rate of temperature increase of 10 °C/min and a measurement temperature range of 30-300 °C, the onset temperature of an exothermic peak observed in said DSC curve is 165 °C or less, the peak temperature is 185 °C or less, and the calorific value is 90 J/g or more.

(57) 要約: 熱硬化性樹脂成分と、エラストマーとを含有するフィルム状接着剤が開示される。昇温速度 10 °C/分及び測定温度範囲 30 ~ 300 °C の条件で示差走査熱量測定を実施して得られるフィルム状接着剤の DSC 曲線において、当該 DSC 曲線で観測される発熱ピークのオンセット温度は 165 °C 以下であり、ピーク温度は 185 °C 以下であり、かつ発熱量は 90 J/g 以上である。



WO 2024/190881 A1

[続葉有]

MZ, NA, NG, NI, NO, NZ, OM, PA, PE, PG, PH, PL,
PT, QA, RO, RS, RU, RW, SA, SC, SD, SE, SG, SK,
SL, ST, SV, SY, TH, TJ, TM, TN, TR, TT, TZ, UA,
UG, US, UZ, VC, VN, WS, ZA, ZM, ZW.

(84) 指定国(表示のない限り、全ての種類の広域保
護が可能): ARIPO (BW, CV, GH, GM, KE, LR, LS,
MW, MZ, NA, RW, SC, SD, SL, ST, SZ, TZ, UG,
ZM, ZW), ユーラシア (AM, AZ, BY, KG, KZ, RU,
TJ, TM), ヨーロッパ (AL, AT, BE, BG, CH, CY, CZ,
DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HR, HU, IE, IS,
IT, LT, LU, LV, MC, ME, MK, MT, NL, NO, PL, PT,
RO, RS, SE, SI, SK, SM, TR), OAPI (BF, BJ, CF,
CG, CI, CM, GA, GN, GQ, GW, KM, ML, MR, NE,
SN, TD, TG).

添付公開書類:

— 国際調査報告 (条約第21条(3))